**烟台德邦科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**证券简称：德邦科技 证券代码：688035 编号：2023-004**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动**  **类别** | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 龙赢富泽资产管理、中银三星人寿、民生加银基金、潼骁投资、同泰基金、鹏扬基金、淳厚基金、惠升基金、方正富邦、中金基金、鸿道投资、乘安资产管理、渤海人寿、中信证券、海富通基金、国泰基金、中信建投证券、金鹰基金、中粮资本、中信建投基金、天治基金、申万菱信基金、中金基金、新华基金、天弘基金、泰康资产、相聚资本、星石投资、拾贝投资、大家资产、陶朱资本、惠升基金、中泰证券、高毅投资、鸿道投资、东方基金、澄明资产、九泰基金、宏利基金、华商基金等 |
| **时间** | 2023年9月4-6日 |
| **地点** | 现场交流（上海、北京） |
| **上市公司接待人员**  **姓名** | 公司证券总监：战世能 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、公司集成电路领域产品收入结构？**  答：2023年上半年公司UV膜产品约占公司集成电路领域收入三成、固晶胶约占公司集成电路领域收入三成、热界面材料约占公司集成电路领域收入四成。另外，公司底部填充胶、AD胶、固晶胶膜（DAF/CDAF）、芯片级导热界面材料（TIM1）四款芯片级封装材料同时在配合多家设计公司、封测公司推进验证。  **2、公司芯片级封装材料国产化程度？**  答：根据公司了解的市场情况，固晶胶膜（DAF）目前还未看到其他国内企业有量产产品，AD胶、底部填充胶和导热界面材料（TIM1）这三款材料有极少数国内公司在做。  **3、公司芯片级封装材料放量时间和顺序？**  答：公司芯片级底填、AD胶、TIM1、DAF/CDAF膜等这几个材料目前整体上还处于验证导入初期阶段，公司今年的主要目标是这几个产品能够通过较多客户的验证。AD胶、固晶膜（DAF）已经开始供货，但订单量还比较小，对我们来说的意义在于实现了从0到1的突破，几个系列产品今年的预期大概是大几百万的量，明年增量增长的机会比较多。  **4、芯片级底填、AD胶、TIM1、DAF膜这个几个材料是否都是应用于先进封装？**  答：芯片级底填、AD胶、TIM1目前主要是应用于倒装芯片封装，底填的应用领域更多一些，包括CSP、COF、2.5D、3D等，一般可以理解为只要有焊球都会用到底填。DAF膜主要是应用于多层芯片的堆叠，目前多应用于存储、逻辑等高算力芯片，DAF膜也可以替代固晶胶。  **5、集成电路上半年整体复苏情况如何？**  答：从已合作的下游客户端了解到的信息分析，上半年下游稼动率整体处于弱复苏的态势，一季度不太明显，二季度比一季度环比有所提升，我们这里判断当前稼动率大约7-8成左右，这个数据不是很全面大家谨参考。  **6、公司产品在华为mate60手机中的应用情况如何？**  答：我们公司与该客户有比较长时间的合作，公司一直非常重视客户端的需求，积极配合测试验证，已有产品在批量供应。但具体应用到哪些终端产品我们公司也很难掌握，客户在提出采购需求时只是提供相应的性能、指标要求，并不会告知具体的应用产品。  **7、公司研发投入会加码还是维持？**  答：公司高度重视研发投入和积累，持续加大研发投入力度，同时在公司内部有对研发费投入的合理规划和监控管理。  **8、公司材料的核心壁垒是什么？**  答：首先是配方，然后是工艺。公司丰富的产品系列，主要来自公司多产品配方体系的技术平台，包括环氧、有机硅、聚氨酯、丙烯酸和聚酰胺，并且都属于复配型产品，在产品开发的科学方法、检测设备、可靠性应用、工艺技术以及量产设备上基本相通，背后的关联性非常紧密，基于这样的机制，公司产品具有种类多、应用领域广泛的特点。  **9、公司业务结构未来的趋势？**  答：集成电路和智能终端是公司未来发展的主要方向，公司集成电路板块今年整体进展加速，智能终端板块期待明年在大客户手机端的产品能够实现突破。同时，随着公司集成电路和智能终端板块的收入占比逐渐上升，公司新能源和高端装备板块的收入占比会相对会有所降低，公司整体业务结构会趋于更为合理。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |